

導電銀膠技術資料

FeedBond[®] FP-5000L

產品說明：

FeedBond[®] FP-5000L 為單液型環氧樹脂導電銀膠接著劑，適用於一般小型半導體及 LED 晶片黏著。

產品特徵：

- 適當流變性及無溶劑型之銀膠
- 中、高黏度，適用於一般作業方式如沾膠及點膠作業
- 熱安定性高
- 在高溫時仍維持好的黏著性及高導熱

硬化前特性		測試條件	測試方法
比重	3.8 g/cc	比重計	FT-P001
外觀	銀灰色		
黏度 @ 25°C	11000~16000cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變指數 @ 25°C	4.5~6.0	Brookfield DV-III/CP-51 黏度 @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	FT-P008
細度	< 20 μm	細度計	FT-P026
水含量	< 0.5 %	水份計	FT-P002
使用壽命 @ 25°C	72 小時	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P024
保存期限 @ -40°C	12 個月		FT-P018
烘烤條件		測試條件	測試方法
標準烘烤條件		60 分鐘 @150°C (烘箱烘烤)	
其他烘烤條件		30 分鐘 @180°C (烘箱烘烤)	
硬化時之熱重損失	<5%		FT-P010
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	>130 g/die	晶片尺寸 11mil × 11mil/ (銀支架)	FT-M012
@150°C	>100 g/die		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

FeedBond[®] FP-5000L 導電銀膠

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	91 °C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數		TMA 膨脹模式	FT-M016
<Tg	45 ppm/°C		
>Tg	180 ppm/°C		
儲存模數			
@-60°C	6696 MPa		
@25°C	6207 MPa	DMA(TA), 試片厚度<1.6mm	FT-M019A
@150°C	109 MPa		
@250°C	97 MPa		
熱/電性質		測試條件	測試方法
體積電阻	0.0004 Ω · cm	四點探針	FT-P017
熱傳導係數	4.0 W/mK	Hot Disk	FT-P022

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(回溫時間30~90鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C或-40°C）儲存，由於不同溫度下之保存將影響產品的保存期限。

儲存溫度	-35°C~-42°C	-18°C~-22°C	0°C~5°C	18°C~28°C
保存期限	12 個月	6 個月	3 個月	3 天